

行业及产业

电子

NVIDIA 投资 40 亿美元扩产光芯片

——电子行业跟踪报告

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：聚源数据，爱建证券研究所

相关研究

- 《电子行业跟踪报告：MLCC 或迎来涨价周期》 2026-03-02
- 《电子行业跟踪报告：字节跳动发布 Seedance 2.0》 2026-02-24
- 《电子行业跟踪报告：摩尔线程推出智能编程服务》 2026-02-09
- 《电子行业周报：AI 算力需求爆发，带动半导体设备、存储赛道景气度上行》 2026-02-03
- 《电子行业跟踪报告：OpenClaw 助力 AI Agent 技术范式升级》 2026-02-03

证券分析师

许亮
S0820525010002
0755-83562506
xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇
S0820125040021
021-32229888-25520
zhujunyu@ajzq.com

投资要点：

- 本周 (2026/3/2-3/8) SW 电子行业指数 (-5.07%)，涨跌幅排名 28/31 位，沪深 300 指数 (-1.07%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：石油石化 (+8.06%)，煤炭 (+3.79%)，公用事业 (+3.42%)，农林牧渔 (+2.12%)，银行 (+1.64%)，涨跌幅后五分别为：传媒 (-6.97%)，有色金属 (-5.47%)，计算机 (-5.29%)，电子 (-5.07%)，建筑材料 (-4.32%)。本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：LED (+1.05%)，品牌消费电子 (-2.08%)，面板 (-3.12%)，涨跌幅后三分别是：半导体材料 (-8.97%)，集成电路制造 (-8.84%)，集成电路封测 (-6.56%)。
- 事件：2026 年 3 月 2 日，NVIDIA 宣布与光通信龙头 Lumentum、Coherent 达成战略合作，并分别向两家公司各投资 20 亿美元，全力支持其研发创新、产品迭代与产能运营。
- 光器件是光通信系统的基础硬件总称，负责光信号的产生、传输、调制、转换与接收。光芯片是光器件上游的核心部件，也是光通信网络的底层核心器件。它是光模块实现光电信号转换的关键载体，通过电信号与光信号的双向转换，支撑通信网络高速、大容量、长距离传输。按照是否需要外部供电驱动，光芯片可分为有源、无源两大类：有源光芯片需外部供电，核心实现光电信号双向转换，主要包括 FP、DFB 芯片等，传输速率覆盖 155M-40G，重点应用于 5G 基站、数据中心、消费电子领域；无源光芯片无需外部供电，核心产品包括 PLC、AWG 芯片。
- 全球光芯片行业由海外龙头高度垄断。QYResearch 数据显示，2024 年全球光芯片市场规模为 262.82 亿元，2025 年市场规模预计为 299.34 亿元；该机构同时预测，2031 年将增长至 707.68 亿元，2025-2031 年复合增长率为 15.42%。中商情报网数据显示，2024 年中国光芯片市场规模 151.56 亿元，同比增长 10.13%，2025 年有望达 159.14 亿元，同比增长 5.00%。全球高端光芯片领域，Coherent、Lumentum、Broadcom、Sumitomo 分别凭借全产业链布局、高速光通信芯片与 VCSEL 技术壁垒、CPO 技术领先优势及 InP 材料核心能力构筑行业核心壁垒，国内高端光芯片国产化水平整体偏低，仅 2.5G、10G 低速率光芯片实现自主可控，25G 及以上高速高端光芯片国产化率仅 4%；国内光模块企业虽具备晶圆外延后道加工能力，但核心外延技术薄弱，高端外延片仍依赖进口。叠加中东地缘冲突等地缘政治因素，作为全球高端光通信核心产业基地的以色列本土核心厂商出货受阻、交付周期拉长，进一步加剧全球供应链不确定性，倒逼国内光芯片产业加快自主技术攻坚。
- 光芯片行业核心受益标的：长光华芯、源杰科技。长光华芯专注高功率半导体激光芯片、高速光通信芯片等产品的研发、生产与销售，产品覆盖工业制造、光通信等领域。公司在高功率激光芯片领域实现多项关键技术突破，多款光通信芯片达成量产或送样，2026 年 2 月通过子公司布局硅光技术，进一步加码下一代光通信技术布局。源杰科技聚焦高速半导体芯片，实现芯片全流程自主研发与规模化量产。公司依托持续研发深耕高端芯片领域，多款 CW 激光器、100G/200G PAM4 EML 芯片实现大批量交付、通过客户验证或推向市场，并同步推进更高速率 EML 芯片核心技术研发，持续完善高速光芯片产品矩阵与技术布局。
- 投资建议：NVIDIA 与 Lumentum、Coherent 达成战略合作，凸显光芯片在 AI 算力产业链的核心地位。全球高端光芯片由海外龙头垄断，国内国产化率相对较低，叠加中东地缘冲突加剧供应链不确定性，高端光芯片国产替代进程加速，建议重点关注国产光芯片产业链的投资机会。
- 风险提示：1) 行业需求不及预期风险；2) 市场竞争加剧风险；3) 供应链与地缘政治风险

目录

1. NVIDIA 投资 40 亿美元扩产光芯片	4
1.1 光芯片是光通信网络的核心器件	4
1.2 光芯片国产替代实现突破	5
1.3 中东地缘冲突加剧光芯片供给受限	6
1.4 国产光芯片重要企业	8
2. 全球产业动态	11
2.1 AMD 服务器率先采取钻石散热新技术	11
2.2 佰维存储发布 2026 年 1-2 月业绩预告	11
2.3 MediaTek 与于 MWC 2026 展示 AI 与通信优势	11
2.4 全球首款 170 GHZ 光调制器发布	12
3. 本周市场回顾	13
3.1 SW 一级行业涨跌幅一览	13
3.2 SW 电子三级行业市场表现	14
3.3 SW 电子行业个股情况	14
3.4 SW 科技行业其他市场表现	15
4. 风险提示	16

图表目录

图表 1：光芯片是光通信网络的核心底层器件	4
图表 2：光芯片可划分为有源、无源光芯片	4
图表 3：全球光芯片市场规模及同比	5
图表 4：中国光芯片市场规模及同比	5
图表 5：重点海外光芯片企业信息汇总	5
图表 6：光芯片国产化率情况梳理	6
图表 7：以色列半导体生态图	7
图表 8：长光华芯营业收入及同比	8
图表 9：长光华芯毛利率	8
图表 10：长光华芯高功率、光通信芯片产品示意图	9
图表 11：源杰科技营业收入及同比	9
图表 12：源杰科技毛利率	9
图表 13：源杰科技研发投入持续加码	10
图表 14：本周 SW 一级行业涨跌幅一览	13
图表 15：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览	14
图表 16：SW 电子个股本周涨跌幅前五	15
图表 17：SW 电子个股本周涨跌幅后五	15
图表 18：本周费城半导体指数	15
图表 19：本周恒生科技指数	15
图表 20：2025 年 4 月-2026 年 3 月中国台湾电子指数涨跌幅一览	16

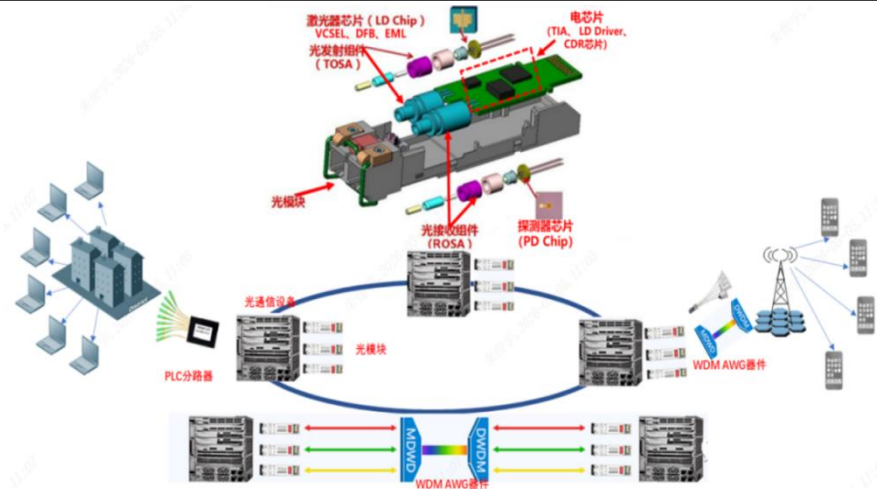
1. NVIDIA 投资 40 亿美元扩产光芯片

事件: 2026年3月2日, NVIDIA 宣布与光通信公司 Lumentum、Coherent 建立战略合作关系, 并将分别向两家公司各投资 20 亿美元, 支持其研发创新、产品迭代与运营发展。

1.1 光芯片是光通信网络的核心器件

光器件是光通信系统的基础硬件总称, 负责光信号的产生、传输、调制、转换与接收。光芯片是光器件上游的核心部件, 也是光通信网络的底层核心器件。它是光模块实现光电信号转换的关键载体, 通过电信号与光信号的双向转换, 支撑通信网络高速、大容量、长距离传输。

图表 1: 光芯片是光通信网络的核心底层器件



资料来源: AET 电子技术应用, 爱建证券研究所

按照是否需要外部供电驱动, 光芯片可划分为有源光芯片、无源光芯片两大类。其中, 有源光芯片需外部供电驱动, 核心功能是实现光电信号的双向转换, 主要包括 FP 芯片、DFB 芯片等品类, 产品传输速率覆盖 155M-40G, 核心应用于 5G 基站、数据中心、消费电子领域; 无源光芯片无需外部供电即可工作, 核心产品涵盖 PLC、AWG 芯片, 主要应用于光纤到户、骨干/核心网及数据中心组网场景。

图表 2: 光芯片可划分为有源、无源光芯片

光芯片	按有源光器件分类		应用场
	器件名称	传输速率 / 传输距离	
有源光器件	激光器芯片	FP芯片: 155M-10G, 20km	5G基站, 数据中心, 消费电子 (VCSEL)
		DFB芯片: 2.5M-40G, 40km	
		EML芯片: 大于10G, 大于40km	
		VCSEL芯片: 155M-25G, 500m	
探测器芯片		PIN芯片: 155M-10G, 小于40km	5G基站, 数据中心
		APD芯片: 1.25G-10G, 长距离	
无源光器件	PLC芯片	实现相同波长的信号的分路和合路	光纤到户, 骨干网/核心网, 数据中心
	AWG芯片	基于PLC将不同波长的光信号实现复用/解复用	
按材料分类	InP	高速直接调制DFB和EML芯片; PIN和APD芯片; 高速调制器芯片; 多通道可调激光器芯片	GaAs: 高速VCSEL芯片; 泵浦激光器芯片
	Si/SiO2	相干光收发芯片; 高速调制器、光开关芯片; TIA, LD Driver, CDR芯片	PLC, AWG, MEMS芯片
	LiNbO3		高速调制器芯片

资料来源: 亿度数据, 爱建证券研究所

1.2 光芯片国产替代实现突破

全球通信迭代升级、AI 算力需求爆发、智能终端广泛渗透与光子技术革新协同共振，共同驱动光芯片行业持续发展。 QYResearch 数据显示，2024 年全球光芯片市场规模为 262.82 亿元，2025 年市场规模预计为 299.34 亿元；该机构同时预测，2031 年将增长至 707.68 亿元，2025-2031 年复合增长率为 15.42%。

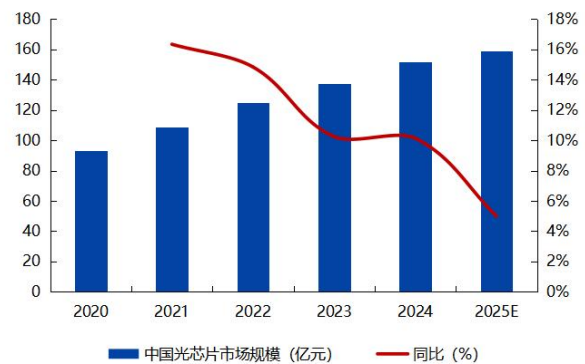
伴随国产替代进程的加速推进，中国光芯片市场规模持续增长。 据中商情报网数据，2024 年中国光芯片市场规模达 151.56 亿元，同比增长 10.13%；到 2025 年中国光芯片市场或将达到 159.14 亿元，同比增长 5.00%，2020-2025 年复合增长率为 11.23%。

图表 3：全球光芯片市场规模及同比



资料来源：QYResearch，爱建证券研究所

图表 4：中国光芯片市场规模及同比



资料来源：中商情报网，爱建证券研究所

全球光通信芯片行业呈现海外垄断格局，Coherent 凭借全产业链布局主导高端光芯片市场，Lumentum 在高速光通信芯片及 VCSEL 领域构筑核心壁垒，Broadcom 引领数据中心 CPO 技术演进，Sumitomo 则依托 InP 材料优势为硅光模块提供核心光源。

图表 5：重点海外光芯片企业信息汇总

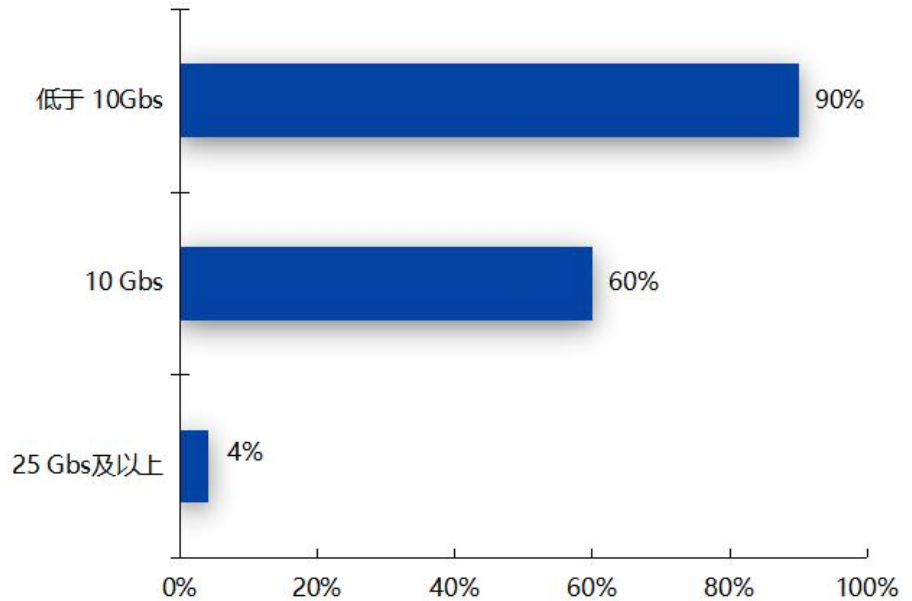
公司	市场情况	最新进展
Coherent	公司通过并购（如 Finisar）整合芯片设计-制造-封装全链条，是高端光芯片技术与份额领导者	2026 年 3 月，NVIDIA 将向其投资 20 亿美元，用于支持美国本土制造、研发及产能扩张，并获得先进激光器与光网络产品的使用权及产能保障。
Lumentum	高端细分市场重要企业：高速光通信芯片（100G+）市占率约 25%；消费电子 VCSEL（手机面部识别）市占率高，依托技术壁垒维持高毛利	2026 年 3 月，NVIDIA 将向 Lumentum 投资 20 亿美元，助力其在美国新建晶圆厂，扩充制造产能。
Broadcom	通信芯片巨头：光模块芯片全球市占率约 20% 数据中心与云计算市场核心供应商	2026 年 2 月，Broadcom 于 ISSCC 上发布了一款用于 51.2T 交换的 6.4Tb/s CPO 专用 ASIC，该 7nm ASIC 与硅光芯片 PIC 采用 3D 封装技术。
Sumitomo	日本精密制造代表，拥有 InP 材料外延片核心技术，良率高，是硅光模块的主要光源供应商	2026 年 3 月，Sumitomo 在 MWC 2026 上展示下一代高速大容量毫米波通信系统与全光网络收发器，该 APN 技术可实现远程波长控制，支持全光子网络路由切换。

资料来源：Lumentum 官网，讯石光通讯网，Broadcom，腾讯云，SUMITOMO ELECTRIC，EET-CHINA，爱建证券研究所

当前国内高端光芯片国产化率相对较低，25G 及以上国产化率仅 4%。 据中商情报网

数据，国内企业仅实现 2.5G、10G 低速率光芯片的核心技术自主可控，而 25G 及以上高速高端光芯片国产化率仅为 4%。国内光模块企业虽普遍具备晶圆外延后道加工能力，但核心外延技术薄弱、高端外延片依赖进口，仍是制约高端光芯片发展的瓶颈。

图表 6：光芯片国产化率情况梳理



资料来源：中商情报网，爱建证券研究所

1.3 中东地缘冲突加剧光芯片供给受限

除海外龙头对高端光芯片的垄断已形成行业核心供给约束外，地缘政治冲突进一步加剧了全球光通信产业链的供给不确定性。其中，中东地缘冲突对以色列光模块及上游核心芯片产业的持续冲击，不仅进一步凸显了光通信产业链自主可控的核心战略价值，更成为加速国内高端光芯片国产替代进程的重要催化因素。

以色列是全球高端光通信核心产业基地，汇聚了 Tower、ColorChip、DustPhotonics 等光芯片、光模块与光器件企业，是北美云厂商与 AI 企业高端光模块的核心供应方。据 2026 年 3 月台湾经济日报报道，随着中东地缘冲突的持续发酵，Tower 以色列本土工厂已出现出货受阻、交付周期拉长的情况，直接影响全球高端光模块的供应链稳定。

图表 7: 以色列半导体生态图



资料来源: Intel Ignite, Cardumen Capital, UCT 爱建证券研究所

对于国内光芯片与光模块产业而言,以色列光模块产业的供给波动,一方面为国内具备高端产品交付能力的光模块企业带来份额提升的机遇,另一方面也倒逼国内光模块企业加速推进上游光芯片的国产验证与替代,减少对海外高端光芯片的进口依赖,为国内高端光芯片企业提供了技术迭代的市場空间。

1.4 国产光芯片重要企业

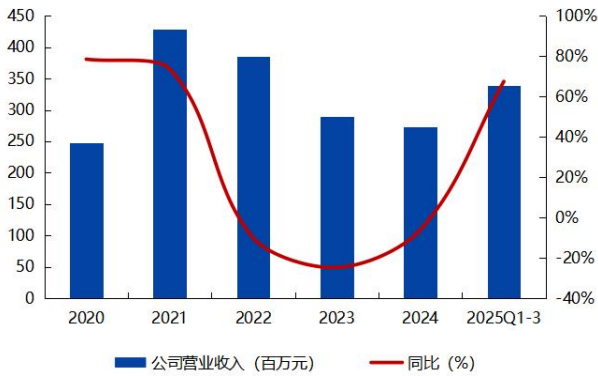
国产光芯片重要的企业主要包括长光华芯与源杰科技。

1.4.1 长光华芯

长光华芯专注于高功率半导体激光器芯片、高效率激光雷达与 3D 传感芯片、高速光通信半导体激光芯片及相关器件和系统的研发、生产与销售。公司主要产品包括高功率单管系列、高功率巴条系列、高效率 VCSEL 系列及光通信芯片系列，广泛应用于工业激光器泵浦、激光先进制造装备、生物医学美容、高速光通信、机器视觉与传感等领域。

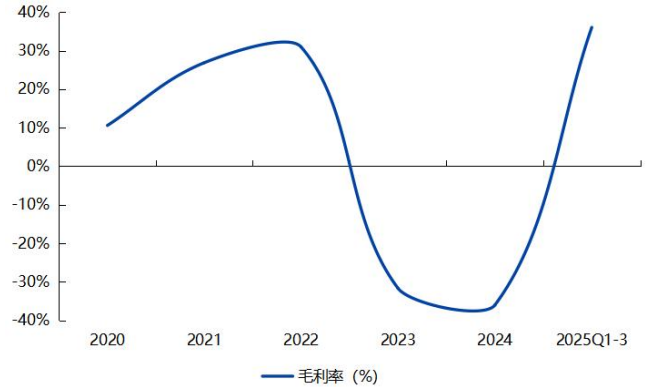
2024 年，全球激光器市场受宏观经济下行、制造业投资放缓拖累，需求端整体疲软，叠加行业供给端产能过剩，产品价格持续走低，公司核心产品光纤耦合模块价格下滑尤为明显，当年公司实现营业收入 2.73 亿元。步入 2025 年，公司经营情况显著回暖、业绩快速反弹，2025Q1-3 营业收入达 3.39 亿元，同比增长 67.42%，同期公司毛利率为 36.03%。

图表 8：长光华芯营业收入及同比



资料来源：长光华芯公司公告，爱建证券研究所

图表 9：长光华芯毛利率



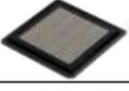



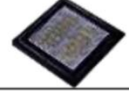








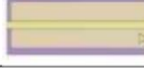

资料来源：长光华芯公司公告，爱建证券研究所

公司坚持开拓创新，持续推出高功率激光与光通信系列产品。

1) 在高功率激光芯片领域，公司超高功率单管芯片在结构设计与研制技术上取得突破性进展。其中，双结单管芯片实现室温连续功率超 132W（芯片条宽 500 μ m，工作效率 62%），开启百瓦级单管芯片发展新纪元。此外，公司还推出 9XXnm 50W 高功率半导体激光芯片，该芯片在 330 μ m 发光区宽度内实现 50W 激光输出，光电转化效率 \geq 62%，是当前市场上量产功率最高的半导体激光芯片。

2) 在光通信芯片领域，公司布局 EML、VCSEL、CW Laser 等多款光通信芯片，可为市场提供高端芯片解决方案。2025H1，公司 100G EML 芯片已实现量产，200G EML 芯片完成送样；100G VCSEL、100mW CW DFB 及 70mW CWDM4 DFB 芯片均已达到量产出货水平。

图表 10: 长光华芯高功率、光通信芯片产品示意图

高功率单管系列产品				
	高功率单管芯片	高功率单管器件	光纤耦合模块	直接半导体激光器
高功率巴条系列产品				
	高功率巴条芯片	高功率巴条器件	阵列模块	
激光雷达与3D传感系列产品				
	激光雷达 VLR 系列	激光雷达 EEL 系列	TOF 系列	SL 系列
光通信芯片系列产品				
	VCSEL 系列	EML 系列	DFB 系列	PIN 系列

资料来源: 长光华芯 2025 半年报, 爱建证券研究所

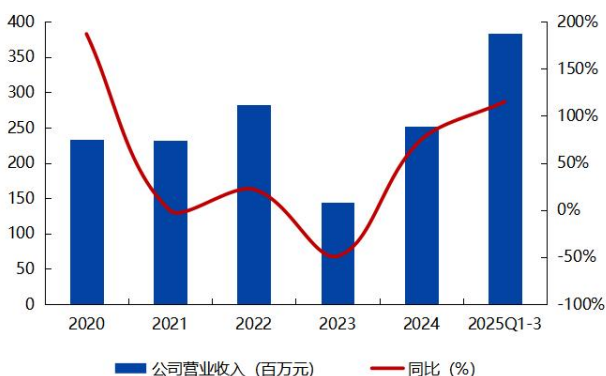
2026 年 2 月, 长光华芯通过全资子公司出资设立苏州星钥光子科技有限公司, 专项布局硅光技术。星钥光子硅光集成项目预计于 2026 年年底完成通线, 该项目旨在搭建 CMOS 硅光芯片平台, 是长光华芯布局下一代光通信技术的关键举措。

1.4.2 源杰科技

源杰科技专注于高速半导体芯片的研发、设计与生产, 实现了半导体晶体生长、晶圆工艺、芯片测试与封装全流程自主开发及规模化生产。公司主营光芯片产品, 广泛应用于光纤到户、数据中心与云计算、5G 移动通信网络等领域。

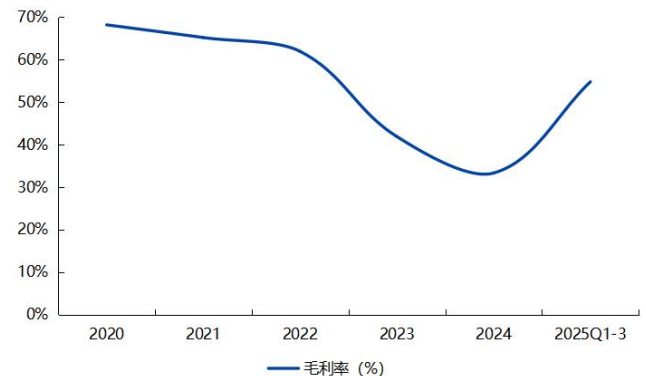
自 2023 年起, 源杰科技营业收入保持稳步增长态势。2024 年公司实现营业收入 2.52 亿元, 同比增长 74.63%。2025Q1-3 公司营业收入达到 3.83 亿元, 同比增长 115.09%。盈利方面, 2024 年公司综合毛利率为 33.32%。

图表 11: 源杰科技营业收入及同比



资料来源: 源杰科技公司公告, 爱建证券研究所

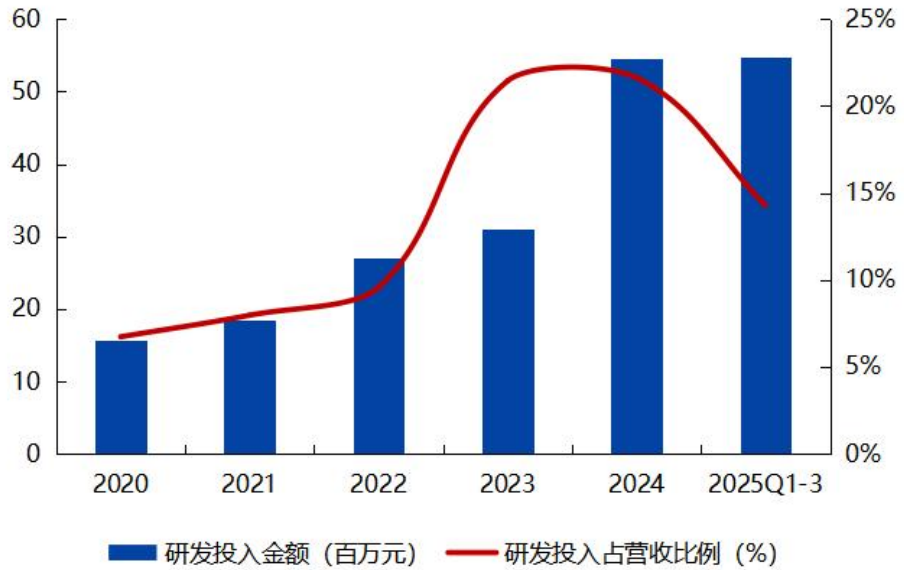
图表 12: 源杰科技毛利率



资料来源: 源杰科技公司公告, 爱建证券研究所

公司研发投入持续加码, 研发投入占营收比例持续提升。2024 年公司研发费用达 0.55 亿元, 占营收比例 21.62%。

图表 13: 源杰科技研发投入持续加码



资料来源：源杰科技公司公告，爱建证券研究所

依托持续的研发投入，公司在高端芯片领域持续深耕。 CW 70mW 激光器产品已实现大批量交付，工艺水平持续优化，该产品采用非制冷设计，兼具高功率输出与低功耗特性，适配数据中心高速应用场景。公司推出的 CW 100mW 激光器产品在保持高可靠性的前提下已顺利通过客户验证，目前 100G PAM4 EML、CW 100mW 芯片均完成客户验证，200G PAM4 EML 芯片已完成开发并推向市场，同时公司正启动更高速率 EML 芯片的核心技术研发，持续完善高速光芯片的产品布局与技术体系。

2. 全球产业动态

2.1 AMD 服务器率先采取钻石散热新技术

2026 年 3 月 3 日, Akash Systems 正式推出并上市首批搭载 AMD Instinct™ MI350X GPU 的 AI 服务器, 该产品搭载了其自研的 Diamond Cooling® 金刚石冷却技术。

Akash 表示, 金刚石是目前已知材料中热导率最高的材质, 散热效率约为行业常用铜材料的 5 倍。依托 Diamond Cooling 金刚石冷却技术, GPU 与高带宽内存 (HBM) 温度最高可降低约 10°C, 能有效减少 GPU 热降频 (thermal throttling) 的发生概率, 使每瓦浮点运算性能 (FLOPs/W) 最高提升 22%, 整体 AI 工作负载吞吐量亦可提升约 15%。

Akash 指出, Diamond Cooling 技术可与现有气冷或液冷系统搭配使用, 在降低 GPU 温度的同时提升数据中心运算密度, 同时有助于降低冷却系统能耗、延长硬件使用寿命。

2.2 佰维存储发布 2026 年 1-2 月业绩预告

2026 年 3 月 3 日, 佰维存储发布 2026 年 1-2 月业绩预告披露公告。

佰维存储预计 2026 年 1-2 月实现营业收入 40 亿元至 45 亿元, 较上年同期增加 30.91 亿元至 35.91 亿元, 同比增长 340%至 395%; 预计实现归母净利润 15 亿元至 18 亿元, 同比增长 921.77%至 1086.13%。

公司业绩大幅增长主要得益于 2026 年存储行业进入高景气周期, AI 算力需求与产业国产化推动 DRAM、NAND 价格持续上涨, 行业供需持续偏紧, 公司显著受益。同时, 为提升产品在 AI 时代的市场竞争力, 公司持续加大芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域的投入。

2.3 MediaTek 与于 MWC 2026 展示 AI 与通信优势

2026 年 3 月 2 日, MediaTek 于 MWC 2026 展出了 6G 技术的前沿进展。MediaTek 率先实现全球领先的 6G 无线接入互通性 (Radio Interoperability), 在保障高速传输的同时, 可实现低时延、低功耗的灵活调度, 为未来生成式 AI 与代理式 AI 服务奠定可靠技术基础。

联发科还提出个人设备云 (Personal Device Cloud) 前瞻技术愿景, AI 代理可通过 Wi-Fi 或 6G 网络, 在安全、连续的运算环境中, 实现个人及家庭设备间的无缝协作。

此外, 联发科还发布了专为 6G 设计的 AI 强化上行发射分集 (AI-accelerated TxD) 技术, 该技术不同于传统基于规则的方案, 可通过 AI 动态学习并适配多变的网络环境, 显著提升上行传输性能。

联发科还展示了 6G 对下一代机器人技术的赋能能力, 借助边缘计算服务, 可按需为

高实时响应、算力密集型应用提供性能支撑。

2.4 全球首款 170 GHz 光调制器发布

2026年3月3日，国家信息光电子创新中心在武汉光谷正式发布全球首款 170GHz 铌酸锂薄膜光电调制器，该产品为超高速光通信领域关键核心器件，体积仅相当于火柴盒大小，被业内称作光通信系统的“信号转换心脏”。此次发布标志着我国在超高频光调制器领域实现从跟跑到全球引领的重大跨越，为下一代高速光传输与 6G 通信提供核心硬件支撑。

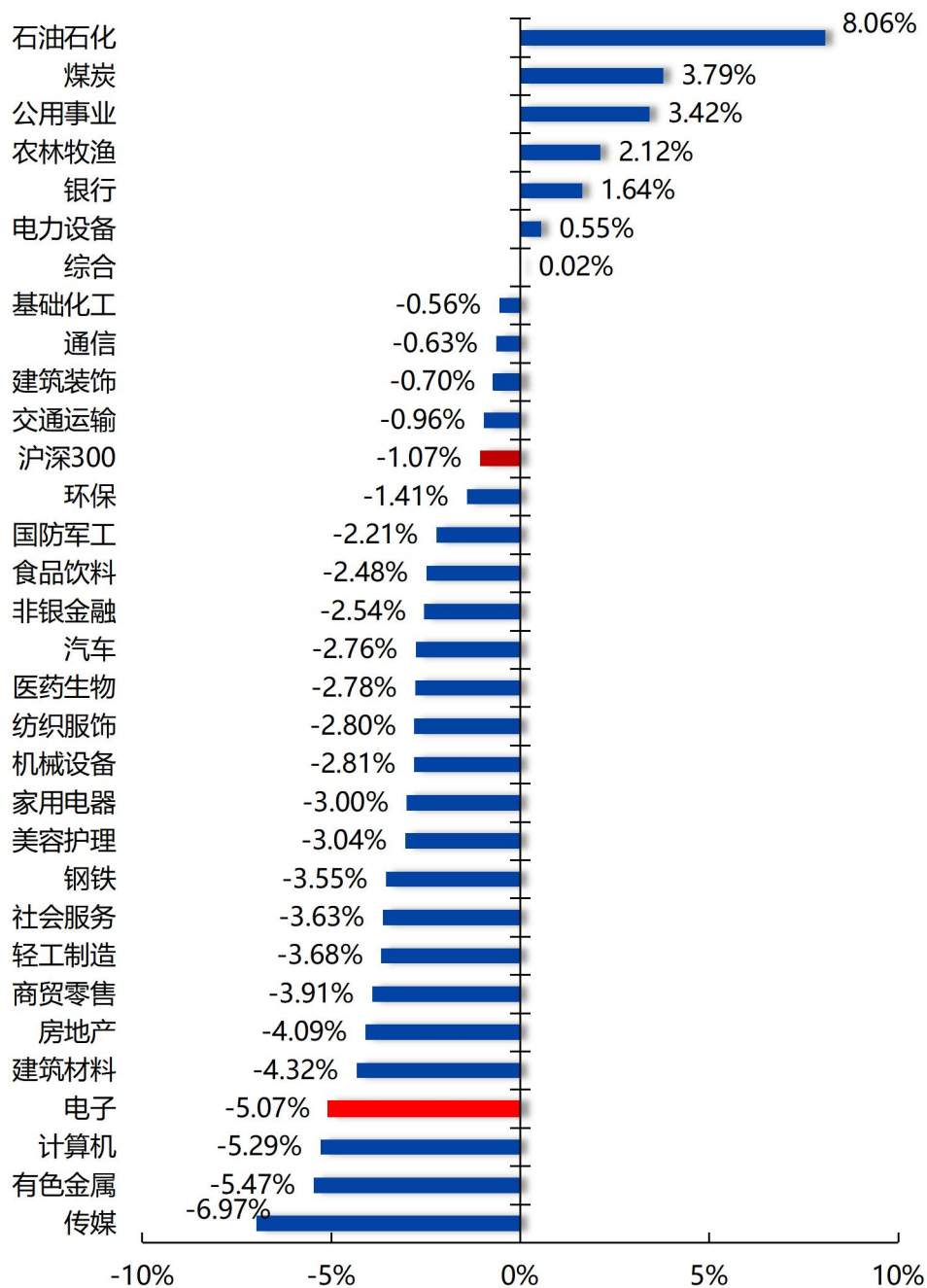
该器件依托自主可控的铌酸锂薄膜平台研制，通过联合仿真优化、高精度封装与倒装键合等自主工艺，实现 170GHz 超高带宽与稳定低损耗传输，实测全频段回波损耗稳定低于-10dB，信号传输效率超 90%，可支撑单通道 1.6Tbps 以上速率传输，未来可直接适配 3.2T 超高速光通信系统。

3. 本周市场回顾

3.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子行业指数 (-5.07%)，涨跌幅排名 28/31 位，沪深 300 指数 (-1.07%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：石油石化 (+8.06%)，煤炭 (+3.79%)，公用事业 (+3.42%)，农林牧渔 (+2.12%)，银行 (+1.64%)，涨跌幅后五分别为：传媒 (-6.97%)，有色金属 (-5.47%)，计算机 (-5.29%)，电子 (-5.07%)，建筑材料 (-4.32%)。

图表 14：本周 SW 一级行业涨跌幅一览

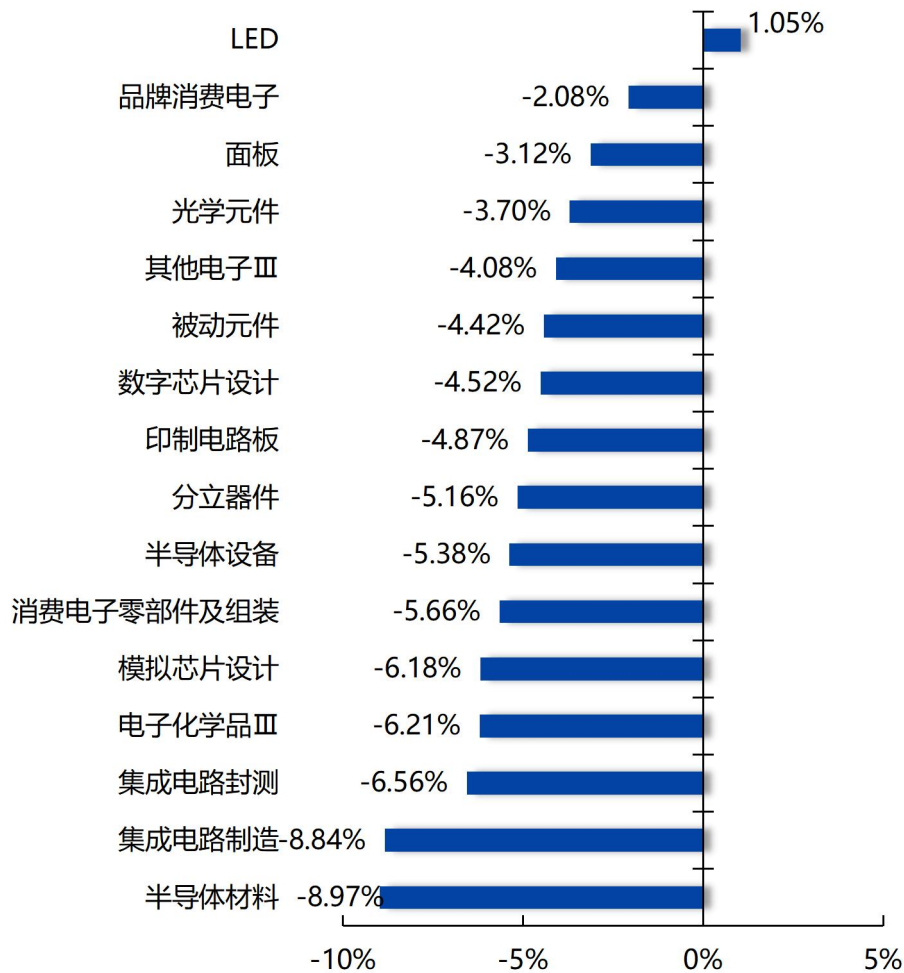


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

3.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：LED (+1.05%)，品牌消费电子 (-2.08%)，面板 (-3.12%)，涨跌幅后三分别是：半导体材料 (-8.97%)，集成电路制造 (-8.84%)，集成电路封测 (-6.56%)。

图表 15：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览



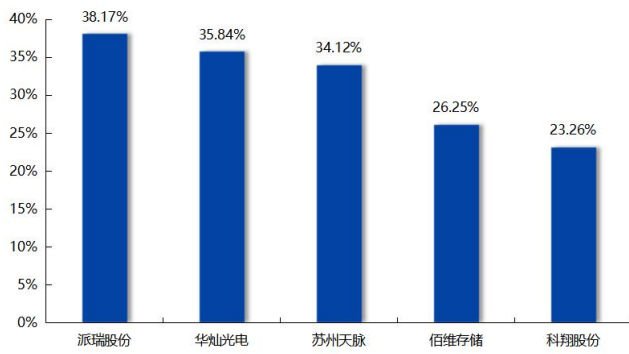
资料来源：iFinD，爱建证券研究所

3.3 SW 电子行业个股情况

本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：派瑞股份 (+38.17%)，华灿光电 (+35.84%)，苏州天脉 (+34.12%)，佰维存储 (+26.25%)，科翔股份 (+23.26%)。

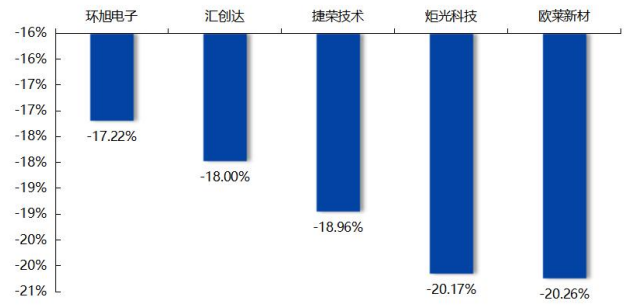
涨跌幅排名后五的股票分别是：欧莱新材 (-20.26%)，炬光科技 (-20.17%)，捷荣技术 (-18.96%)，汇创达 (-18.00%)，环旭电子 (-17.22%)。

图表 16: SW 电子个股本周涨跌幅前五



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

图表 17: SW 电子个股本周涨跌幅后五

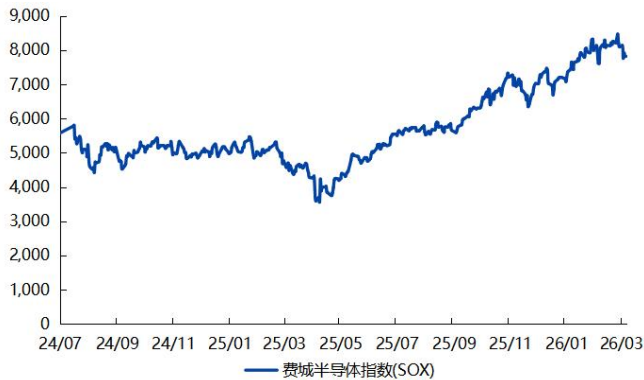


资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

3.4 SW 科技行业其他市场表现

半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为-3.42%，恒生科技指数本周涨跌幅为-3.70%。

图表 18: 本周费城半导体指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

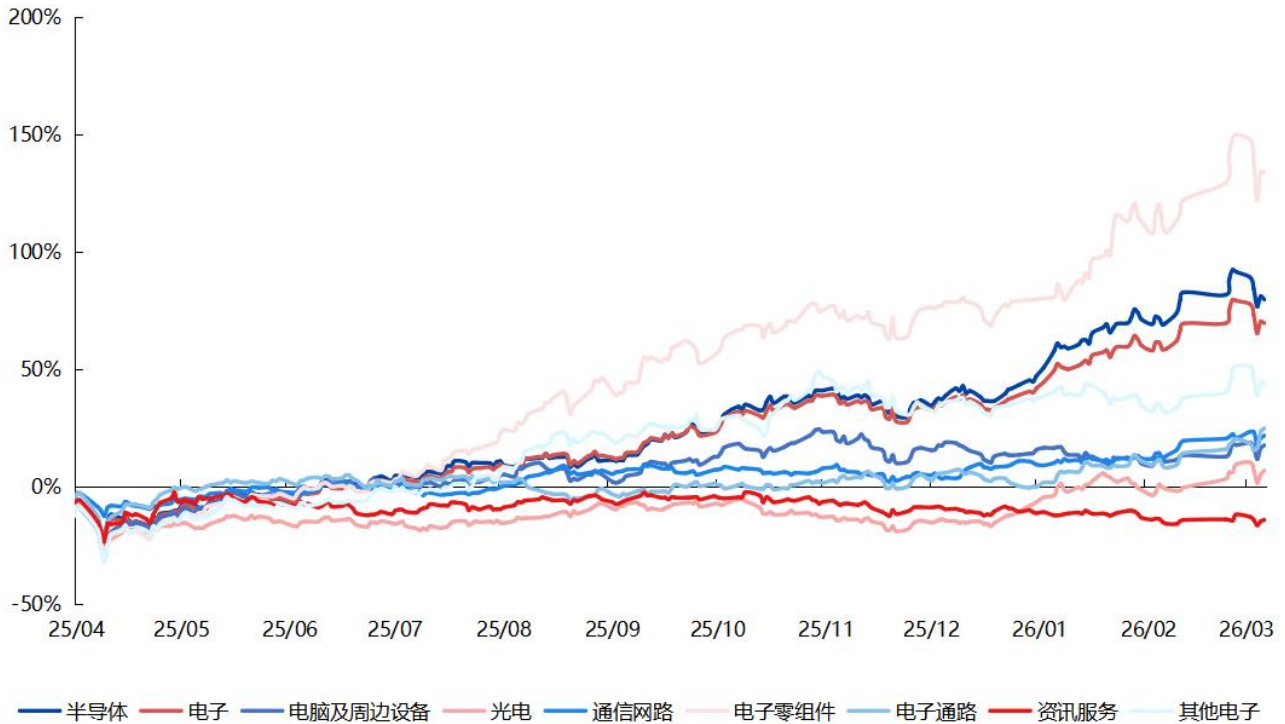
图表 19: 本周恒生科技指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

中国台湾电子指数各板块本周涨跌幅分别是: 半导体 (-6.13%), 电子 (-5.33%), 电脑及周边设备 (-0.12%), 光电 (-2.34%), 通信网络 (+0.81%), 电子零部件 (-6.44%), 电子通路 (+3.76%), 资讯服务 (-2.55%), 其他电子 (-4.92%)。

图表 20: 2025 年 4 月-2026 年 3 月中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

4. 风险提示

- 1) **行业需求不及预期风险:** AI 算力建设、数据中心及光模块需求增长不及预期, 可能导致光芯片行业景气度下滑。
- 2) **市场竞争加剧风险:** 海外光芯片龙头持续扩产、国内行业竞争加剧, 可能引发产品价格下行, 导致企业毛利率承压。
- 3) **供应链与地缘政治风险:** 巴以冲突等地缘问题持续发酵, 叠加海外设备、材料、外延片依赖度较高, 产业链供给存在不确定性。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5%~5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。